

附件

享受企业所得税优惠政策的国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业 主要留存备查资料

企业类型	资料清单（复印件须加盖企业公章）
集成电路设计企业	1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等； 2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占企业职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关材料； 3.企业开发销售的主要产品和服务列表（名称/领域/对应销售（营业）收入规模）； 4.企业拥有与主营产品相关的不少于8项的已授权发明专利、布图设计登记、计算机软件著作权登记证书的材料； 5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及集成电路设计销售（营业）收入、集成电路自主设计销售（营业）收入、研究开发费用等情况表； 6.第三方检测机构提供的集成电路主要产品测试报告或用户报告，以及与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件； 7.企业具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境的材料。
集成电路装备企业	1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等； 2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占企业职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关材料； 3.企业开发销售的主要产品列表（名称/规格）； 4.企业拥有与主营产品相关的不少于5项的已授权发明专利材料； 5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及集成电路装备销售（营业）收入、研究开发费用等情况表；

企业类型	资料清单（复印件须加盖企业公章）
	6.与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件； 7.企业具有与集成电路装备生产相适应的经营场所、软硬件设施等材料。
集成电路材料企业	1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等； 2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占企业职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关材料； 3.企业开发销售的主要产品列表（名称/规格）； 4.企业拥有与主营产品相关的不少于5项的已授权发明专利材料； 5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及集成电路材料销售（营业）收入、研究开发费用等情况表； 6.与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件； 7.企业具有与集成电路材料生产相适应的经营场所、软硬件设施等材料。
集成电路封装、测试企业	1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等； 2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占企业职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及汇算清缴年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关材料； 3.企业开发销售的主要产品列表（名称/规格）； 4.企业拥有与主营产品相关的不少于5项的已授权发明专利、计算机软件著作权登记证书的材料； 5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及集成电路封装、测试销售（营业）收入、研究开发费用等情况表； 6.与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件； 7.企业具有与集成电路封装、测试相适应的经营场所、软硬件设施等材料。